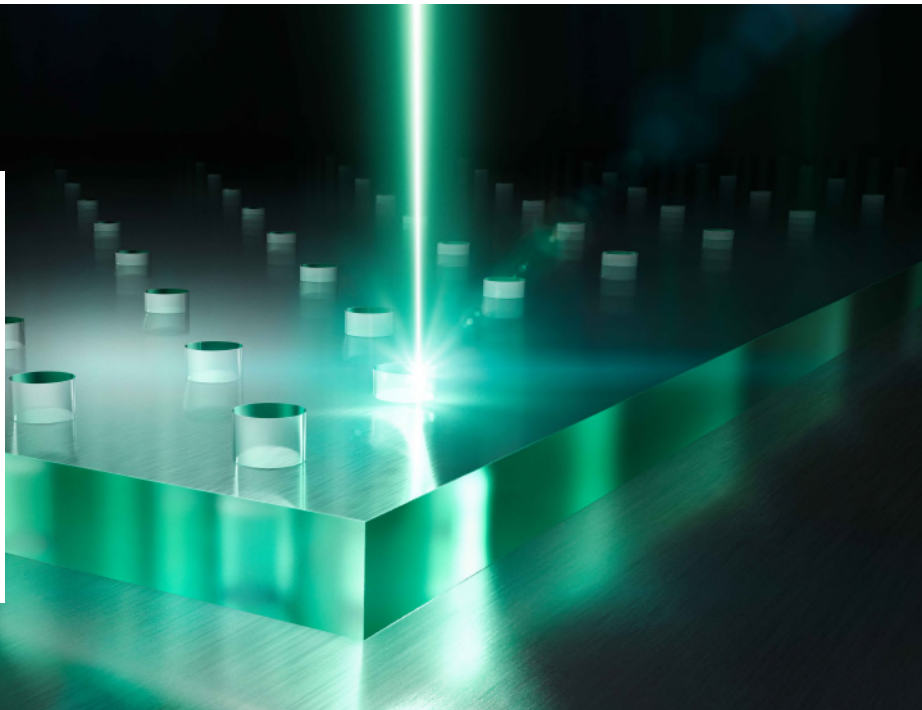


OPIE'23 出展のお知らせ

2023年4月19日（水）～21日（金）

於：パシフィコ横浜

トルンプ株式会社 ブース番号A-12
(展示ホール)



お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

さて、弊社は4月に開催される「OPIE'23 レーザ-EXPO」に出展いたします。最新加工サンプルを多数展示し、微細加工に関する最新のアプリケーションのご紹介をいたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

2023年3月吉日

トルンプ株式会社 レーザ事業部 事業部長 バスティアン・ベッカー

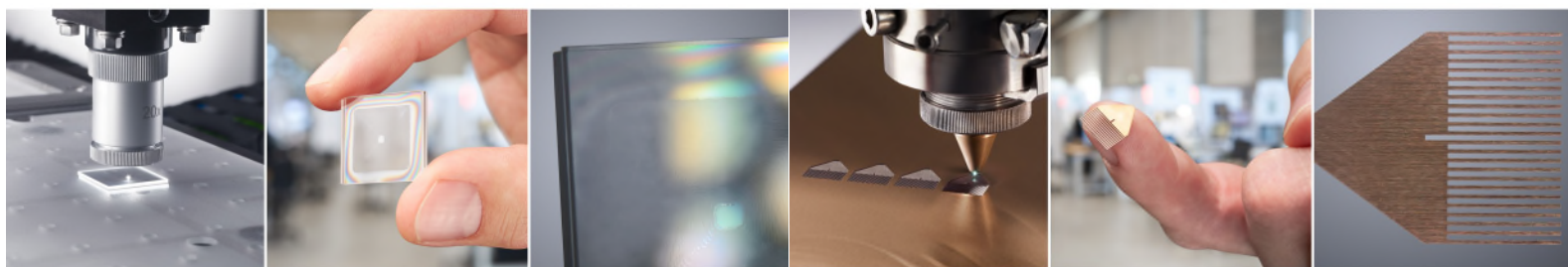
トルンプ出展のみどころ

高速通信や自動運転などで必要とされる部品の微細加工技術は、ますます需要が高まるなかで、レーザ加工への期待もより大きくなってきています。

トルンプのブースでは、難加工材（セラミック、半導体、シリコン、ガラス等）への表面剥離、微細穴あけ・溝加工・切断などの加工サンプルを展示し、最新技術をご覧いただけます。

ウェブサイトやカタログだけではわかりづらい、トルンプの微細加工技術を一目でご覧いただける機会です。ぜひこの機会をご活用ください。

当展示会は事前登録制です。ご登録を[OPIE'23 オフィシャルサイト](#)でお済ませの上、ご来場ください。



トルンプ株式会社 レーザ事業部
〒226-0006 横浜市緑区白山1-18-2
TEL 045-931-8333 laser@jp.trumpf.com
www.trumpf.com

